2022년 1월 28일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
* 통신·방송·인터넷은 1월 27일(목) 12:00 이후 보도 가능

중소벤처기업부

보 도 자 료

대한민국 대전환 한국판뉴딜

• 문의 : 중소벤처기업부 미래산업전략팀 오지영 팀장(044-204-7680), 김도완 사무관(7683), 노치홍 주무관(7684)

중기부, 칩 제조기업(파운드리)와 설계전문기업(팹리스) 상생협력 이끌어

- 시스템반도체 세계시장 선도할 설계전문기업(팹리스) 육성 가속화 -

□ 권칠승 장관, 1.27(목) 삼성전자 칩 제조기업(파운드리) 방문해 시제품(MPW) 공정 확대 등 중소 설계전문기업(팹리스)의 현장 애로 해결방안 논의

□ 1.28(금)에는 국내 모든 칩 제조기업(파운드리) 기업과 설계전문기업(팹리스) 단체, 중기부가 한자리에 모이는 「설계전문기업(팹리스) - 칩 제조기업(파운드리) 상생협의회」 발족

시스템반도체 산업을 이끌어 가는 칩 제조기업(파운드리)과 설계전문기업(팹리스) 기업 간 '대중소 상생협력'이 대폭 강화될 전망이다.

중소벤처기업부(이하 '중기부')는 권칠승 장관(이하 '권장관')의 칩 제조기업(파운드리) 현장 방문에 이어, 「설계전문기업(팹리스) - 칩 제조기업(파운드리) 상생협의회」를 발족하고 본격 운영해 나갈 계획이라고 밝혔다.

1 삼성전자 칩 제조기업(파운드리) 현장방문

중기부 권장관은 '22.1.27(목), 삼성전자 화성캠퍼스* 현장을 방문하여 삼성전자 칩 제조기업(파운드리)사업부 최시영 사장과 만나, 중소 설계전문기업(팹리스) 지원을 위한 협력방안을 논의했다.

* 삼성전자 반도체 국내 생산시설(총 4개, 화성·기흥·평택·온양/천안) 중 메모리반도체와 칩 제조기업(파운드리)가 주력인 사업장

< 삼성전자 현장방문 개요 >

- **일시 :** '22. 1. 27(목) 16:20 ~ 17:20
- **장소 :** 삼성전자 화성캠퍼스(경기도 화성시 삼성전자로)
- **참석** : (중기부) 권장관, 차정훈 창업벤처혁신실장, 김희천 중소기업정책관
  (삼성전자) 최시영 사장 등 칩 제조기업(파운드리)사업부 임원

< 칩 제조기업(파운드리) 현장방문의 의미 >

이날 현장방문은 전(全) 세계적인 칩 제조기업(파운드리) 수급 불안정이 지속되는 상황에서, 국내 중소 설계전문기업(팹리스)의 생산 애로를 해소하기 위해서는 설계전문기업(팹리스) 기업과 칩 제조기업(파운드리) 간 상생협력이 무엇보다 중요하다는 점에서 추진됐다.

대기업이 설계부터 생산까지 전담하는 메모리반도체와는 달리 시스템반도체는, 주로 중소기업이 영위하는 반도체 설계전문기업인 설계전문기업(팹리스) (Fab-less)가 제조전문기업인 '칩 제조기업(파운드리)*'에 생산을 위탁하는 분업화된 산업 구조를 갖고 있다.

* 국내 칩 제조기업(파운드리) : 삼성전자, 키칩 제조기업(파운드리), 디비(DB)하이텍, 에스케이(SK)하이닉스 시스템아이씨(IC) (가나다 順)

칩 제조기업(파운드리) 수급 불안정은 설계전문기업(팹리스) 기업의 신제품 검증과 칩 양산에 어려움을 초래해 시스템반도체 분야 경쟁력 약화를 초래하는 주요 원인이 될 수 있다고 지적돼 왔다.

실제로, 미국과 대만에 이어 중국도 전세계 설계전문기업(팹리스) 시장에서 빠르게 성장*하는 데 반해, 우리나라는 전세계 설계전문기업(팹리스) 시장 점유율이 정체상태이며, 설계전문기업(팹리스) 기업들도 영세성**을 면치 못하고 있는 것으로 나타났다.

* 전세계 설계전문기업(팹리스) 시장 점유율(%) : 미국 59.3, 대만 21.3, 중국 14.6, 한국 1.5

** 국내 설계전문기업(팹리스)의 약 97%가 중소기업(기업당 매출액 22억원, 고용인원 21명, 업력 7년 등)이고, 글로벌 설계전문기업(팹리스) 50위권 내에 우리나라는 단 1개

권장관은 4차 산업혁명과 산업 간 융합에 핵심인 시스템반도체 산업 육성을 위해서는 국내 중소 설계전문기업(팹리스)에 대한 체계적인 지

원이 필요하다고 보고, 작년 설계전문기업(팹리스) 기업('21.9)과 칩 제조기업(파운드리) 기업들('21.11)을 차례로 만나 문제점에 대해 토론했다.

중기부는 이를 반영해 중소 설계전문기업(팹리스)의 설계 및 생산부터 판매까지 전주기 지원을 위한 정책과제를 마련*('21.11, BIG3회의)하여 추진중이다.

* ① 설계 (공공IP뱅크, 인력양성, 자금지원 등), ② 생산 (묶음발주, 대중소 상생협의체, 공공나노팹 고도화), ③ 판매 (대스타해결사플랫폼, 컨소시엄형R&D)

권장관은 이날 현장방문에서 "반도체 산업이 4차 산업혁명 등으로 더욱 중요해지고, 특히 시스템반도체 분야는 향후 게임체인저로써 성장동력이 되었다"면서,

"설계전문기업(팹리스) 기업들은 창업에서부터 신제품 개발, 최종 판매에까지, 시제품 생산이나 개발된 제품의 수요 창출 등에 어려움이 있어, 설계전문기업(팹리스)와 칩 제조기업(파운드리)의 협력이 매우 중요하다"라고 말했다.

또한, "우리나라는 세계 최고 수준의 칩 제조기업(파운드리)가 있고, 혁신기술을 가진 설계전문기업(팹리스)도 하나둘 탄생*하는 등 성장가능성이 높은 시점이다"라면서,

* ① 퓨리오사에이아이(AI)(글로벌 AI 반도체 대회에서 세계 최강 기술력 입증), ② 퀄리타스반도체(창업 2년만에 삼성전자 칩 제조기업(파운드리) 협력사로 발전), ③ 오픈엣지테크놀로지(한국판 ARM으로 불리는 IP 개발기업) / 3개 회사 모두 '17년 창업, 중기부 지원사업 참여 중

"창의적인 제품개발이 촉진되고, 이것이 시제품 제작과 판매로 이어지도록 대·중소 상생협력을 강화해 나가자"고 강조했다.

< 주요 논의내용 >

아울러, 협력방안으로는 ① 중소 설계전문기업(팹리스)의 시제품(MPW) 공정 제공을 확대하고, ② 설계전문기업(팹리스)·칩 제조기업(파운드리) -

정부 간 협업과제 추진방안 등을 논의해 나가기로 했다.

삼성전자 칩 제조기업(파운드리)사업부 최시영 사장은, “중기부의 대·중소 상생협력 취지에 깊이 공감하며, 국내 중소 설계전문기업(팹리스)의 경쟁력 향상을 위해 삼성전자도 힘을 보태겠다”고 말했다.

2 「설계전문기업(팹리스)·칩 제조기업(파운드리) 상생협의회」 발족

한편, 중기부는 국내 모든 칩 제조기업(파운드리)와 중소 설계전문기업(팹리스) 단체가 참여하는 「설계전문기업(팹리스) - 칩 제조기업(파운드리) 상생협의회」(이하 ‘협의회’)를 오늘인 1.28일 발족한다.

< 설계전문기업(팹리스) - 칩 제조기업(파운드리) 상생협의회 발족식 개요 >

- **일시 :** ’22. 1. 28(금) 14:00 ~ 15:00
- **장소 :** 대중소협력재단 대회의실 (서울 구로구)
- **참석** : (설계전문기업(팹리스) 업계) 한국시스템반도체포럼, (칩 제조기업(파운드리)) 삼성전자, 키칩 제조기업(파운드리), 디비(DB)하이텍, 에스케이(SK)하이닉스 총 4개사 (가나다順), (중기부) 중소기업정책관

협의회는 설계전문기업(팹리스) 업계와 칩 제조기업(파운드리) 간 정례적인 소통 채널로서, 앞서 제시된 협력방안을 구체화하고, 상생협력 성과를 확산하기 위한 실무 중심의 협의체이다.

특히, 올해에도 설계전문기업(팹리스)의 시제품 수요가 상반기에 집중돼 병목*이 우려되는 상황임을 고려할 때, 상생협의회는 칩 제조기업(파운드리)의 수요와 공급 불일치(미스매칭) 해소에 기여할 것으로 기대된다.

* 올해 국내 칩 제조기업(파운드리)의 시제품 공정 예약이 2분기까지 완료됐고, 일부 칩 제조기업(파운드리)는 연말까지 마감되어 설계전문기업(팹리스) 기업의 시제품 개발에 어려움이 예상되는 상황

중기부 권칠승 장관은 “중소 설계전문기업(팹리스)와의 상생 발전을

위한 칩 제조기업(파운드리) 기업들의 노력에 감사드린다”며,

“협의회를 계기로 설계전문기업(팹리스)와 칩 제조기업(파운드리)가 함께 성장해 우리나라가 시스템반도체 강국으로 도약할 기반을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 김도완 사무관(☎ 044-204-7683)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 1 삼성전자 칩 제조기업(파운드리) 현장방문 개요

1. 추진배경

○ 「시스템반도체 중소 설계전문기업(팹리스) 지원방안」('21.11.18)에 따라 설계부터 생산, 판매에 이르기까지 지원역량을 집중해 **정책과제*** 추진 중

* ① 설계 (IP뱅크, 인력양성, 자금지원 등), ② **생산** (묶음발주, **대중소 상생협의체**, 공공나노팹 고도화), ③ 판매 (대스타플랫폼, 컨소시엄형R&D)

○ 주요 정책과제인 **대중소 상생협의체**(설계전문기업(팹리스)·칩 제조기업(파운드리) 상생협의회) **발족**에 앞서, **칩 제조기업(파운드리)**와의 **협력 강화**를 위한 현장방문 추진

2. 행사개요

□ (일시 /장소) '22. 1. 27(목) 16:20 ~ 17:20 /삼성전자 화성캠퍼스 (MR 1동)

□ (참석자) 권칠승 장관, 삼성전자 칩 제조기업(파운드리)사업부 최시영 사장 등

* (중기부) 차정훈 창업벤처혁신실장, 김희천 중소기업정책관 / 최기창 서울대 교수

□ (주요내용) ❶ 칩 제조기업(파운드리) 소개, 협력방안 논의 등, ❷ 생산공정 참관

3. 세부일정(안)

시간	주요 내용	참고	비고
16:20~16:22	■ 기념촬영	-	비공개
16:22~16:25	■ 모두발언	권칠승 장관	
16:25~16:28	■ 환영인사	최시영 사장	
16:28~16:33	■ 삼성전자 칩 제조기업(파운드리) 소개(영상)	삼성전자	
16:33~16:36	■ 설계전문기업(팹리스) 현장애로 발표	최기창 교수	
16:36~17:05	■ 협력방안 논의	권칠승 장관 주재	
17:05~17:20	■ 칩 제조기업(파운드리) 공정 투어	주요 참석자	

참고 2 「설계전문기업(팹리스)·칩 제조기업(파운드리) 상생협의회」 개요

□ 추진배경

○ 설계전문기업(팹리스)와 칩 제조기업(파운드리)간 **정례적**인 **소통 채널 마련**으로, 시스템반도체 분야 **상생협력**의 성과를 확산하기 위한 **실무 중심**의 **협의체** 구축

□ 협의회 구성·운영

○ 국내 **모든 칩 제조기업(파운드리)***와 **중소 설계전문기업(팹리스) 단체**** 및 **중기부**로 구성

* 칩 제조기업(파운드리) : 삼성전자, 키칩 제조기업(파운드리), DB하이텍, SK하이닉스 시스템IC(가나다 順)

** 설계전문기업(팹리스) 단체 : 한국시스템반도체포럼(회장 '픽셀플러스' 이서규 대표)



- **설계전문기업(팹리스) 단체 임원진**(4명 내외), 국내 **칩 제조기업**

(파운드리)(임원급), 중기부(중소기업정책관) 참석, **분기 1회 주기**로 개최

○ **발족** (Kick-off 회의) : **'22.1.28(금) 14시**, 대중소기업협력재단(서울 구로)

□ 주요 논의안

○ 중소 설계전문기업(팹리스) **시제품(MPW) 제작 수요조사·반영** 추진

○ 설계전문기업(팹리스) 및 칩 제조기업(파운드리) **업계 주요 이슈** 및 **신기술 동향** 논의

○ 정부와 설계전문기업(팹리스)·칩 제조기업(파운드리) **협력과제 발굴** 추진 등

□ 세부일정

시간	주요 내용	참고	비고
14:00~14:05	■ 기념촬영 등	-	-
14:05~14:10	■ 모두발언	중소기업정책관	
14:10~14:15	■ 설계전문기업(팹리스) 단체 대표 발언	이서규 대표	
14:15~15:00	■ 토론	참석자 전원	비공개